

Hirata

平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2026年2月

決算説明資料

2025年度 (2026年3月期)
第3四半期

目 次

- I. 2025年度 第3四半期業績(連結)
- II. 2025年度 通期業績予想(連結)
- III. 参考資料

※2025年度:2026年3月期

会社概要

会社名	平田機工株式会社 (英文表記: HIRATA Corporation)
所在地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長 平田 雄一郎
設立	1951年12月29日
資本金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード 6258)
従業員	連結 2,371名 単体 1,574名 ※2025年12月31日現在
事業所	国内7拠点(熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都)
関係会社	国内3社 (熊本県2社、東京都) 海外9社 (アメリカ、メキシコ、シンガポール、マレーシア、中国2社、台湾、タイ※、ドイツ※)

※ タイとドイツの関係会社は清算手続き中

2025年度
I. 第3四半期業績（連結）

業績概要

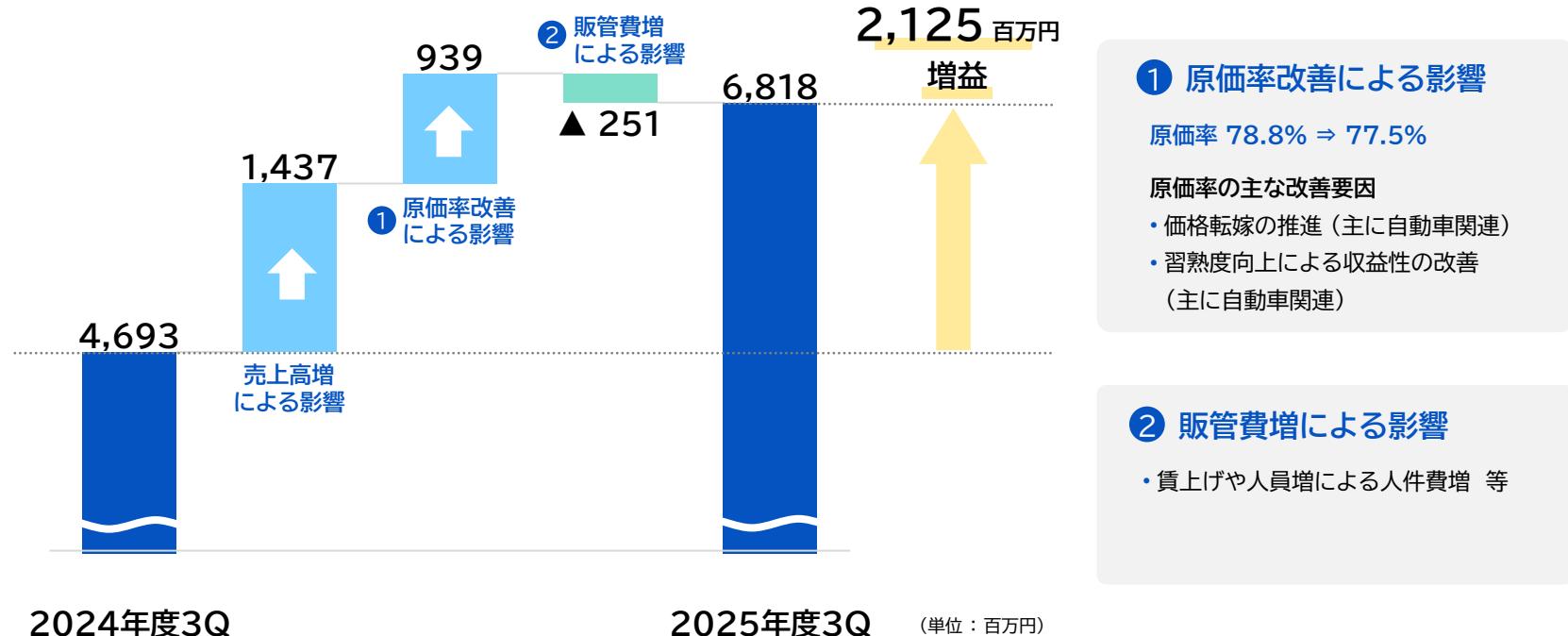
- **受注高** 対前年同期で増。自動車関連で大型案件を継続的に受注。半導体関連でも生成AI関連の需要を取り込み受注が伸長
- **売上高** 対前年同期で増。受注の増加を受け、自動車関連・半導体関連の両セグメントにおいて生産が進捗
- **営業利益** 対前年同期で増。增收効果に加え、自動車関連・その他自動省力機器における原価率改善が貢献し増益

(単位：百万円)

	2024年度3Q	2025年度3Q	対前年同期	
	実績	実績	増減額	増減率
受注高	58,958	71,961	13,002	22.1%
売上高	62,323	69,118	6,795	10.9%
受注残高	62,040	59,276	▲2,763	▲4.5%
営業利益 営業利益率	4,693 7.5%	6,818 9.9%	2,125	45.3%
経常利益	4,502	6,927	2,425	53.9%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	2,939	4,703	1,764	60.0%

営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前年同期で2,125百万円増
 - 主な増加要因：売上高の増加、原価率の改善



セグメント別業績まとめ

※ セグメント間取引消去は「その他」に含む

(単位：百万円)		2024年度3Q	2025年度3Q	増減額	増減率
受注高	合計	58,958	71,961	13,002	22.1%
	自動車	27,863	38,419	10,555	37.9%
	半導体	21,695	23,347	1,651	7.6%
	その他自動省力機器	7,741	8,565	824	10.6%
	その他	1,658	1,629	▲28	▲1.7%
売上高	合計	62,323	69,118	6,795	10.9%
	自動車	30,061	33,525	3,463	11.5%
	半導体	21,409	24,468	3,058	14.3%
	その他自動省力機器	9,319	9,520	200	2.2%
	その他	1,531	1,604	72	4.7%
受注残高	合計	62,040	59,276	▲2,763	▲4.5%
	自動車	36,952	35,096	▲1,856	▲5.0%
	半導体	19,756	17,892	▲1,863	▲9.4%
	その他自動省力機器	4,716	5,595	878	18.6%
	その他	614	692	77	12.5%
営業利益	合計	4,693	6,818	2,125	45.3%
	自動車	2,688	4,468	1,779	66.2%
	半導体	2,544	1,693	▲850	▲33.4%
	その他自動省力機器	▲525	599	1,124	—
	その他	▲14	57	71	—

セグメント別業績：自動車関連

- **受注高** 対前年同期で増。北米向け内燃機関（ICE）関連、およびHV関連案件が増加
- **売上高** 対前年同期で増。EV関連（主にEDU）の売上は減少したものの、ICE関連が増加し、全体としては增收
- **営業利益** 対前年同期で増。增收効果に加え、適正な価格設定や習熟度向上により収益性が改善

(単位：百万円)

	2024年度3Q		2025年度3Q		対前年同期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	27,863	-	38,419	-	10,555	37.9%
EV (HV含む)	19,814	71.1%	15,714	40.9%	▲4,099	▲20.7%
ICE 等	8,049	28.9%	22,704	59.1%	14,655	182.1%
売上高	30,061	-	33,525	-	3,463	11.5%
EV (HV含む)	19,774	65.8%	18,157	54.2%	▲1,617	▲8.2%
ICE 等	10,286	34.2%	15,368	45.8%	5,081	49.4%
受注残高	36,952	-	35,096	-	▲1,856	▲5.0%
営業利益	2,688	-	4,468	-	1,779	66.2%
営業利益率	8.9%	-	13.3%	-	-	-

セグメント別業績：半導体関連

- **受注高** 対前年同期で増。引き続き生成AI関連向けを中心に受注が好調。特にファウンドリ向けが増加
- **売上高** 対前年同期で増。ウェーハ搬送装置を中心に生産が進捗。その他では主にパッケージング関連が増加
- **営業利益** 対前年同期で減。部材価格の高騰および価格転嫁の遅れにより原価率が悪化。ただし2Q以降は原価改善や価格転嫁の取り組みが進む

(単位：百万円)

	2024年度3Q		2025年度3Q		対前年同期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	21,695	-	23,347	-	1,651	7.6%
ウェーハ搬送	17,672	81.5%	16,681	71.4%	▲991	▲5.6%
その他	4,022	18.5%	6,665	28.6%	2,642	65.7%
売上高	21,409	-	24,468	-	3,058	14.3%
ウェーハ搬送	15,002	70.1%	17,442	71.3%	2,440	16.3%
その他	6,407	29.9%	7,025	28.7%	618	9.7%
受注残高	19,756	-	17,892	-	▲1,863	▲9.4%
営業利益	2,544	-	1,693	-	▲850	▲33.4%
営業利益率	11.9%	-	6.9%	-	-	-

セグメント別業績：その他自動省力機器

- **受注高** 対前年同期で増。主に有機EL関連案件を受注
- **売上高** 前年同期並み。家電関連の売上は減少したものの、有機EL関連が増加
- **営業利益** 対前年同期で増。不採算案件の剥落に加え、利益率の高い有機EL関連の売上増が寄与し増益

(単位：百万円)

	2024年度3Q		2025年度3Q		対前年同期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	7,741	-	8,565	-	824	10.6%
売上高	9,319	-	9,520	-	200	2.2%
受注残高	4,716	-	5,595	-	878	18.6%
営業利益	▲525	-	599	-	1,124	-
営業利益率	▲5.6%	-	6.3%	-	-	-

貸借対照表

(単位：百万円)

資産	2024年度	2025年度3Q	増減	負債・純資産	2024年度	2025年度3Q	増減
流動資産	88,035	99,238	11,203	流動負債	43,295	53,806	10,511
現金及び預金	12,882	27,252	14,369	仕入債務	10,574	10,224	▲350
売上債権	56,561	49,939	▲6,622	短期借入金*	22,330	27,122	4,792
棚卸資産	15,510	19,193	3,682	その他	10,390	16,459	6,069
その他	3,080	2,853	▲227	固定負債	18,143	18,024	▲119
固定資産	42,243	45,068	2,825	長期借入金	11,836	11,534	▲301
有形固定資産	26,592	27,857	1,264	その他	6,307	6,489	181
無形固定資産	1,160	1,163	2	負債合計	61,439	71,831	10,391
投資その他の資産	14,489	16,048	1,558	純資産合計	68,839	72,476	3,636
資産合計	130,278	144,307	14,028	負債純資産合計	130,278	144,307	14,028

主な増減要因

現金及び預金：顧客からの入金により増加

売上債権：顧客からの入金により減少。回収条件も改善傾向

流動負債その他：顧客からの前受金の受領により契約負債が増加

※ 1年内返済予定の長期借入金を含む

2025年度
II. 通期業績予想（連結）

通期業績予想

- 2025年度は売上高 960億円、営業利益 84億円の増収増益見通し ※2024年度決算発表時(2025年5月)より修正はございません

(単位：百万円)

	2024年度	2025年度	対前期	
	実績	通期予想	増減額	増減率
売上高	88,483	96,000	7,516	8.5%
自動車関連	43,059	※43,000	▲59	▲0.1%
半導体関連	30,186	※36,000	5,813	19.3%
その他自動省力機器	13,096	※15,000	1,903	14.5%
その他	2,141	※2,000	▲141	▲6.6%
営業利益（率）	6,898 (7.8%)	8,400 (8.8%)	1,501	21.8%
経常利益（率）	6,889 (7.8%)	8,200 (8.5%)	1,310	19.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益（率）	4,778 (5.4%)	5,700 (5.9%)	921	19.3%

※ 売上高のセグメント内訳については期初時点の想定数値です

1株当たり配当金・配当性向 推移および予想

(単位：円)

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 予想
1株当たり配当金※	21.7	21.7	30.0	33.3	40.0	65.0
連結配当性向(%)	16.6	25.2	21.9	23.9	25.9	35.3

自己株式の取得額：約10億円
総還元性向：46.7%

＜配当に対する考え方＞

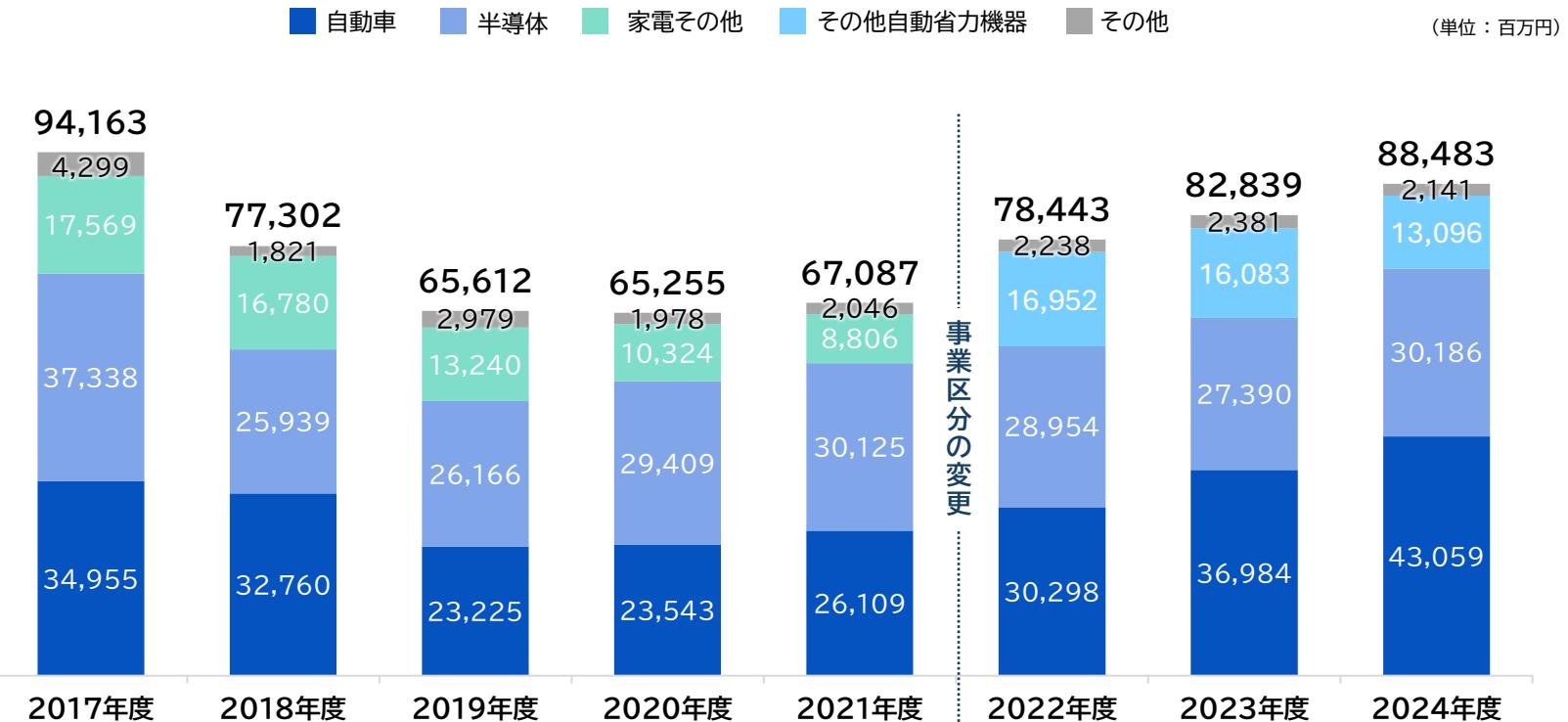
2025年度以降の配当につきましては、中期経営計画（2025-2027年度）で定める企業価値向上に向けた成長戦略に基づき、キャッシュ・アロケーション方針における成長投資と株主還元の配分を定め、連結配当性向の目安を20%から35%の水準に引き上げることといたしました。

2025年度につきましては、期末配当として1株当たり65円を予想しております。

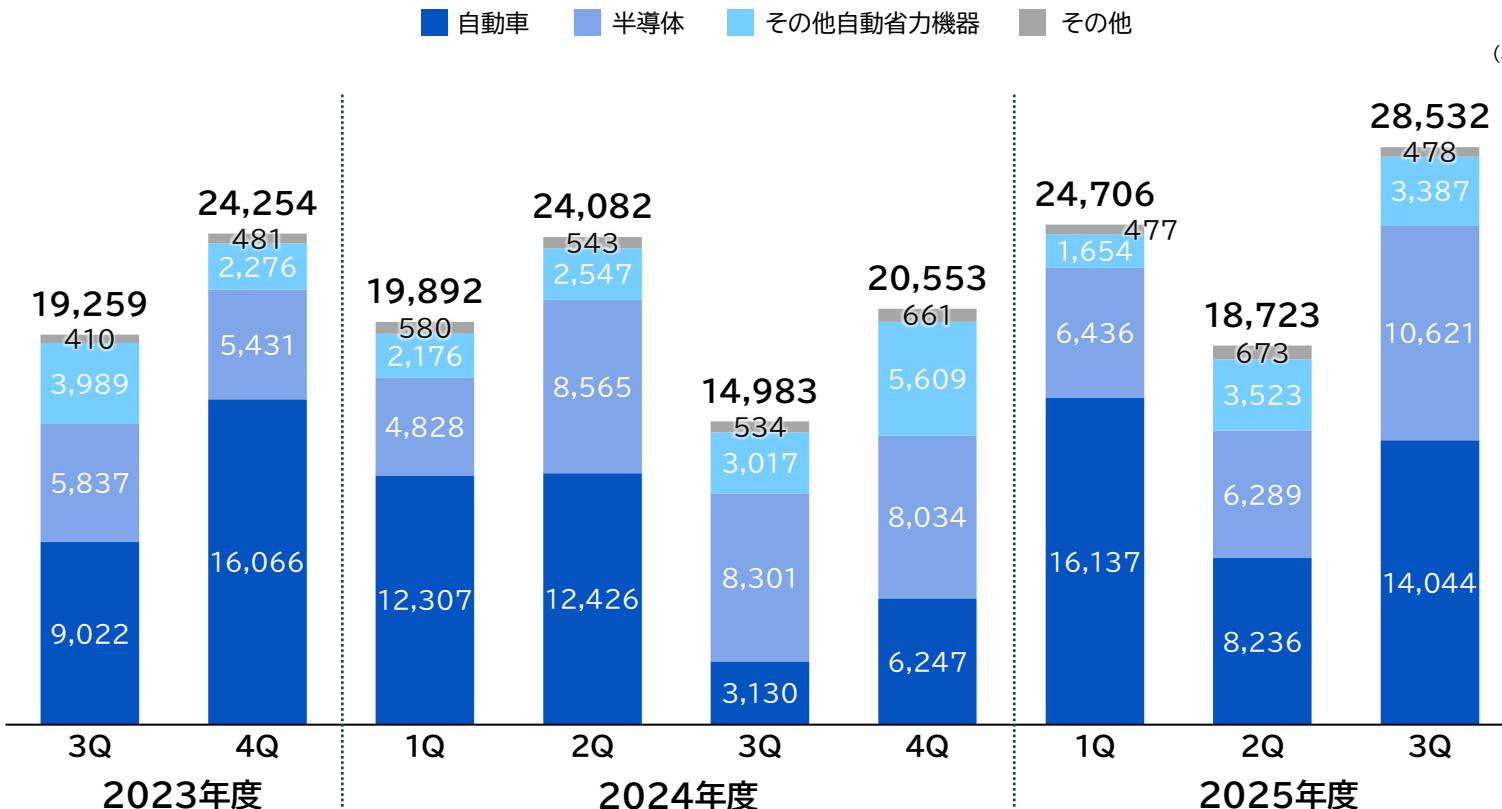
※ 1株当たり配当金は2025年4月1日を効力発生日とする株式分割(3分割)の影響を考慮した金額を記載

III. 參考資料

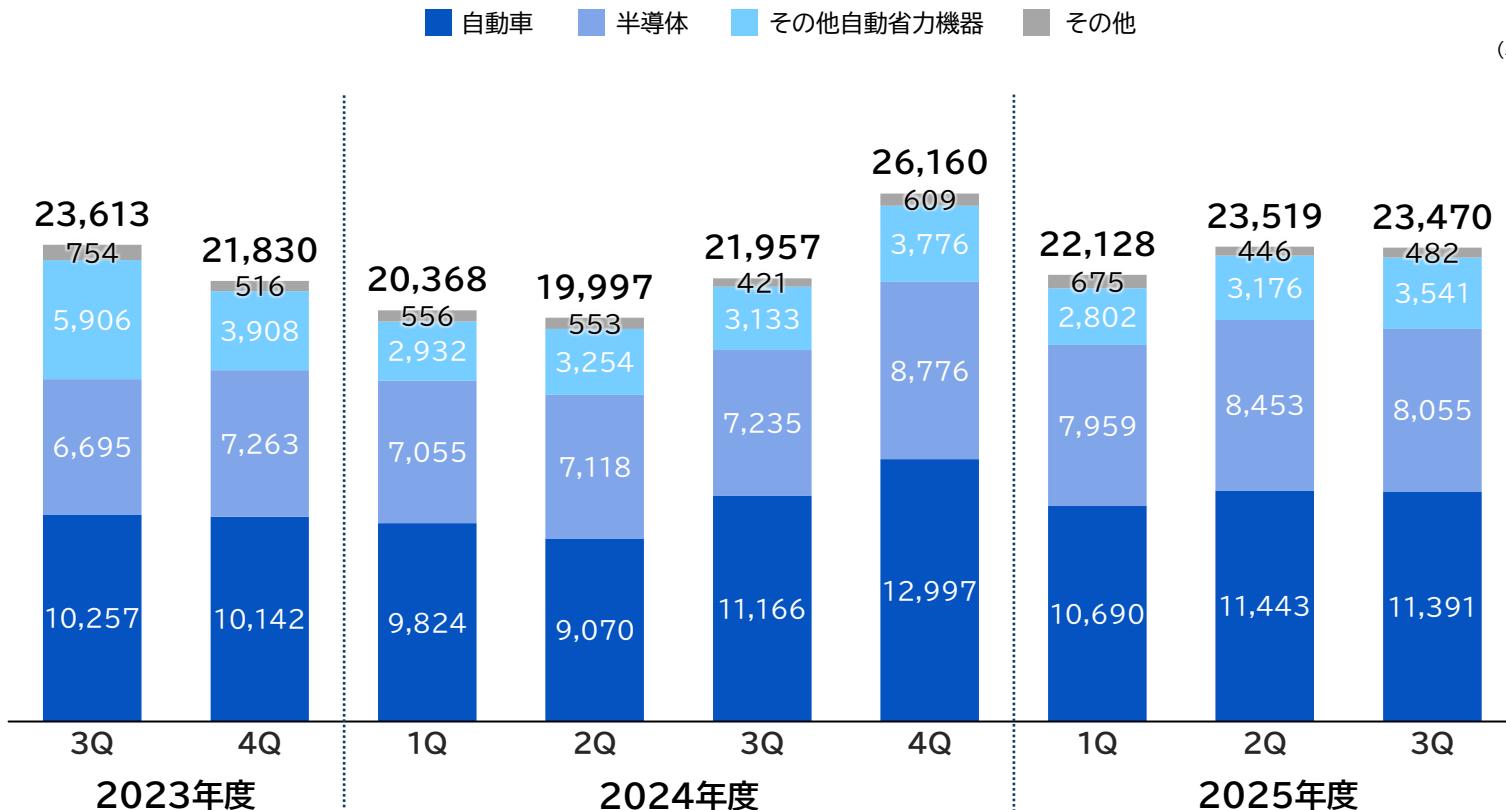
セグメント別 売上高（2017年度～2024年度）



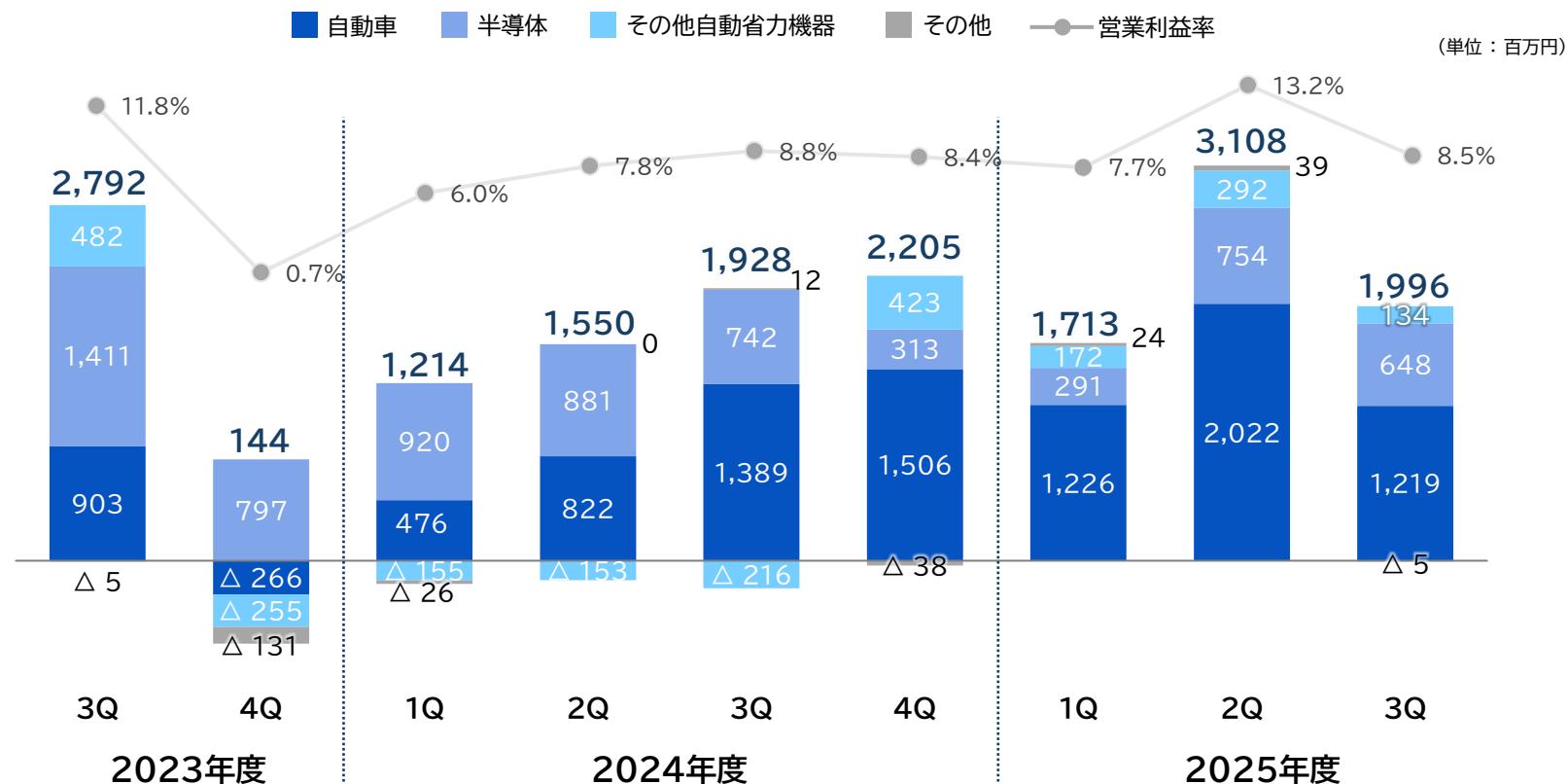
セグメント別 受注高（四半期推移）



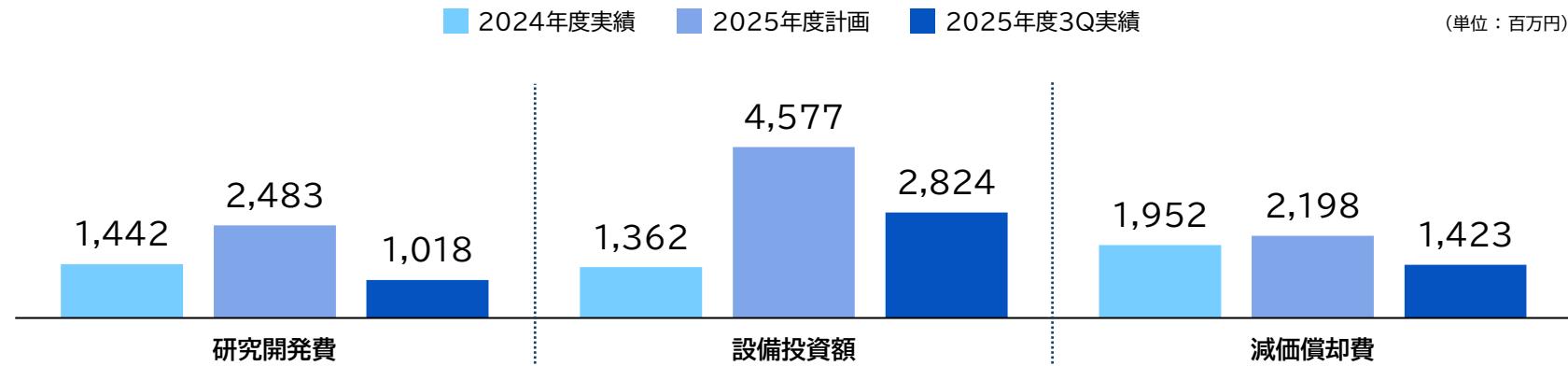
セグメント別 売上高（四半期推移）



セグメント別 営業利益 (四半期推移)



研究開発費・設備投資額・減価償却費



研究開発費 実績 ※1,018 百万円

・量産製品や次世代製品の開発

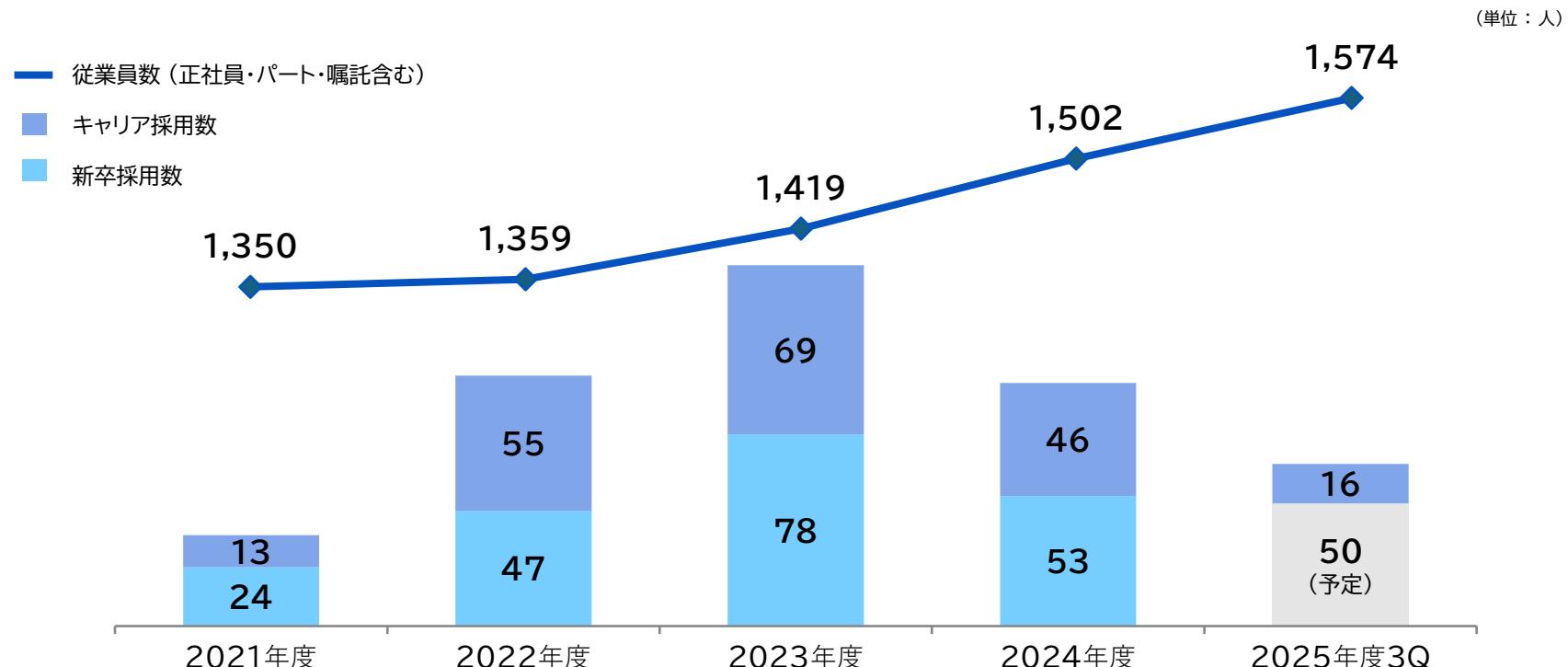
設備投資額 実績 2,824 百万円

・主に制御盤の生産拠点として、七城第二工場を取得（土地・建物）
・その他生産能力増強に資する設備投資を実施

※ 事業活動上、技術開発や改良に伴う費用が発生していますが、個別案件に紐づくものについては原価として計上しており、当該研究開発費には含めておりません。

採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む



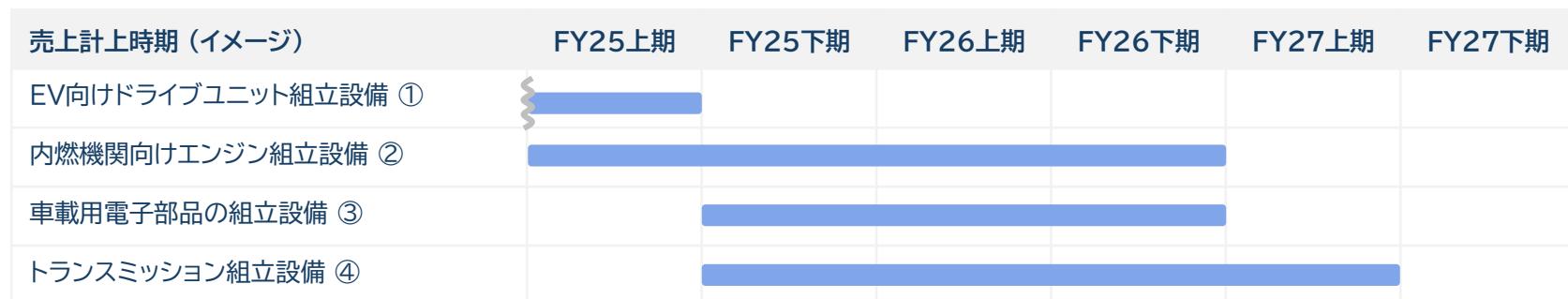
外部環境認識

セグメント	当社の外部環境認識	
自動車関連	▲	<ul style="list-style-type: none"> 米国の関税政策を受けた、米国内での設備投資拡大 内燃系やHV系の設備投資が増加基調
	▼	<ul style="list-style-type: none"> 為替変動による海外市場での価格競争力への影響 消費減速に伴う設備投資の減退
半導体関連	▲	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI関連を中心とした設備投資の拡大 パッケージングの技術革新によるクリーン搬送需要の高まり
	▼	<ul style="list-style-type: none"> 地政学リスクに起因する国際情勢や経済動向の変化 大口顧客の方針転換
その他自動省力機器	▲	<ul style="list-style-type: none"> さまざまな業界・分野における自動化・省力化ニーズの高まり（物流、医療 等）
	▼	<ul style="list-style-type: none"> 従来より取引のあった顧客の設備投資が減少

開示情報：大型案件の受注

- 大型設備案件を継続的に受注。工事の進捗に応じて売上を計上

開示日	設備概要		金額
2024年度	5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約25億円
	8月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約56億円
	8月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備 ①	約87億円
2025年度	5月	内燃機関向けエンジン組立設備 ②	約100億円
	9月	車載用電子部品の組立設備 ③	60億円超
	12月	トランスミッション組立設備 ④	約80億円



ESG経営の取り組み強化

2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足 HPに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化	
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名	
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入	
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明	
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定 サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置	 FTSE Blossom Japan Index
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初選定	
	11月	「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」への参画	
2025年	3月	EcoVadis サステナビリティ評価「シルバーメダル」獲得	 SILVER Top 15%

事業概要：自動車関連の主要製品

- 北米自動車メーカー（ビッグ3）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカー等向けに各種生産設備を製造・販売

自動車関連の主力・拡大分野

主力分野

エンジン組立設備

ガソリンやディーゼル等のエンジンの組立を行う設備。パーツの数が非常に多いため、長いものは総延長1kmを超える場合もある



当社がつくる設備



最終製品

主な顧客・北米自動車メーカー（ビッグ3）

主力分野

EDU組立設備

EDU (Electric Drive Unit) と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備



当社がつくる設備



最終製品

主な顧客・北米自動車メーカー（ビッグ3）
・北米新興EVメーカー

主力分野

IGBT・インバーター組立設備

IGBTやインバーターといった、EVやトランスマッ션車に搭載される車載用電子部品の組立設備



当社がつくる設備



最終製品

主な顧客・国内車載用電子部品メーカー

当社の競争優位性

- EV・内燃機関向けを問わず幅広い製品を手掛けてきた対応力
- 最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- 開発から生産・保守までの一貫体制、顧客要求に応えるエンジニアリング力



自動車市場の転換/顧客の戦略変更に対応

Hirata

事業概要：半導体関連の主要製品

- ウェーハやパネルの搬送装置を製造装置メーカー・デバイスマーケター等に製造・販売

半導体関連の主力・拡大分野

主力分野

ウェーハ搬送装置

シリコンウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、大気・真空環境に対応可能なウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEMを製造



主な顧客 • 国内製造装置メーカー
• デバイスマーケター/ファウンドリ

拡大分野

PLP向け搬送装置

PLP工程等に使用される、パネル基板搬送用のEFEM、ロードポート、搬送ロボットを製造



主な顧客 • 国内製造装置メーカー
• デバイスマーケター/ファウンドリ

拡大分野

基板搬送装置

基板製造メーカー向けに、サブストレート基板製造用の搬送設備を製造



主な顧客 • 国内基板製造メーカー

当社の競争優位性

- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見や技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制、顧客要求に応えるエンジニアリング力

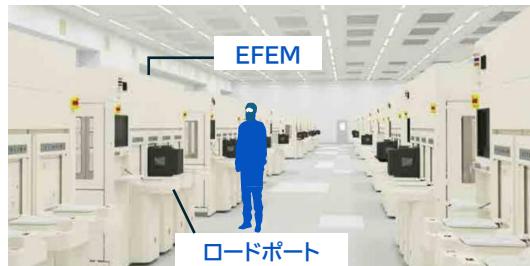


ウェーハ搬送装置

PLP向け搬送装置

事業概要：ウェーハ搬送装置

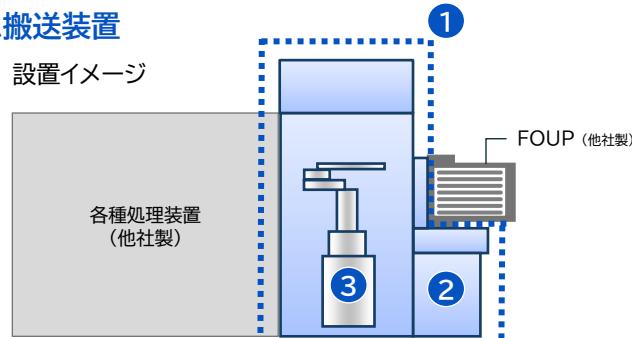
- 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、ウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEM(イーフェム)を設計・製造



- 各種処理装置ごとに EFEM・ロードポートが設置される
- 1つのラインで複数の EFEM・ロードポートが用いられる

ウェーハ搬送装置

設置イメージ



- ① **EFEM (Equipment Front End Module)**
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前部にロードポートが設置される
- ② **ロードポート**
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている
- ③ **ウェーハ搬送ロボット**
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器



事業概要：PLP

- 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

半導体製造工程



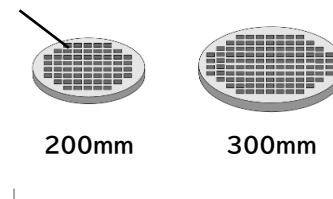
パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
WLP (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、良品チップのみをウェーハに再配列し、チップがウェーハ上有る状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
PLP (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、良品チップのみを四角形のパネルに再配列し、チップがパネル上有る状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける

PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的にウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用

再配列されたチップ



事業概要：その他自動省力機器

- 有機ELの蒸着装置や、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

その他自動省力機器の主力・新規分野

主力分野

有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

主な顧客・国内製造装置メーカー

主力分野

医療・理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

主な顧客・国内医療専門メーカー

このほか、さまざまな産業分野の自動化・省力化ニーズに応じた設備や装置を提案・製造

当社の競争優位性

- ・さまざまな分野の生産設備・装置に携わって
きた豊富な知見とノウハウ
- ・開発から生産・保守までの一貫体制
- ・顧客要求に応えるエンジニアリング力

収益化に向けた新規分野

超音波ガイド下 集束超音波治療装置

- ・すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス株式会社（本社：東京都中央区、以下「ソニア社」）と共同開発中
- ・ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- ・臨床試験中であり、量産化に向けて順調に進捗している

本資料のお取扱い上のご注意

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください。